

第36回春季講演大会 プログラム (3月24日)

論文NO	発表日	start	発表カテゴリ	発表分類	タイトル	著者	所属
24A1-1	3月24日	9:00	(2) ヘルスキア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス1	依頼講演	コンフォーマル印刷による日用品のセンサ化技術と見守り応用	○野村健一	国立研究開発法人産業技術総合研究所
24A1-2	3月24日	9:30	(2) ヘルスキア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス1	論文発表	焦電型高精度温度センサアレイに関する研究 (第2報) —駆動時における変形特性の解析—	○千田優大 [†] 、小林健 ^{††} 、高松誠一 [†] 、伊藤寿浩 [†]	[†] 東京大学、 ^{††} 国立研究開発法人産業技術総合研究所
24A1-3	3月24日	9:45	(2) ヘルスキア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス1	論文発表	模型を用いた喉下音発生機序に関する研究	○吉岡謙香、高松誠一、伊藤寿浩	東京大学
24A1-4	3月24日	10:00	(2) ヘルスキア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス1	論文発表	AI活を使用したストレッチャブル配線基板	○中尾凌、田健吾、南山偉明	東洋アルミニウム(株)
24A2-1	3月24日	10:35	(2) ヘルスキア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス2	論文発表	環境調和型生体電極の検討	○高松誠一、遠藤聡、伊藤寿浩	東京大学
24A2-2	3月24日	10:50	(2) ヘルスキア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス2	論文発表	機能性高分子を用いたストレッチャブル加速度センサの作製	○関根智仁 [†] 、伊藤圭法 [†] 、庄司宜徳 [†] 、竹田泰典 [†] 、熊木大介 [†] 、Fabrice domingues dos Santos ^{††} 、宮保淳 ^{†††} 、時任静士 [†]	[†] 山形大学、 ^{††} Piezotech(株)、 ^{†††} アルケマ(株)
24A2-3	3月24日	11:05	(2) ヘルスキア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス2	論文発表	伴侶動物の体導破産計測用首輪型デバイスのための突起状中間体構造の設計	○大塚武、伊藤寿浩、高松誠一	東京大学
24A2-4	3月24日	11:20	(2) ヘルスキア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス2	論文発表	接客現場における感情推定のためのマルチモーダルウェアラブルデバイスの研究	○工藤悠佑、高松誠一、伊藤寿浩	東京大学
24A3-1	3月24日	13:00	(12) 配線板とその製造技術1	論文発表	エッチング抑制剤を用いた微細回路エッチング	○野口裕太、楢垣忠弘、柏崎史	(株)ADEKA
24A3-2	3月24日	13:15	(12) 配線板とその製造技術1	論文発表	電気銅めっき添加剤種における異なるスルーホール径へのフィリング性能とその考察	○眞鍋達、立花真司	上村工業㈱
24A3-3	3月24日	13:30	(12) 配線板とその製造技術1	論文発表	狭ピッチパンプに対応した最終表面処理の検討とその実装信頼性	○真田昌樹、今藤桂	新光電気工業㈱
24A3-4	3月24日	13:45	(12) 配線板とその製造技術1	論文発表	ピリミジン誘導体を用いたシアンフリー銀めっき浴の電気化学的解析	○Atiqah Binti Jasni ^{††} 、吉原佐知雄 [†] 、齋藤光 [†] 、相木文男 ^{††} 、渡邊秀樹 ^{††}	[†] 宇都宮大学、 ^{††} メルテックス(株)
24A4-1	3月24日	14:20	(12) 配線板とその製造技術2	論文発表	ベンダブル性を有する多層ビルドアップ基板への実装技術開発	○滝沢優哉、小林慶裕、種子田浩志、秋山尚輝、清水規良、片桐規貴	新光電気工業㈱
24A4-2	3月24日	14:35	(12) 配線板とその製造技術2	論文発表	マルチワイヤ配線板の高集積化への対応	山口洋志、貫名俊介、○前田侑弥	リンクステック㈱
24A4-3	3月24日	14:50	(12) 配線板とその製造技術2	論文発表	分子接合技術(i-SB法)による高周波伝送対応三次元成形回路部品の開発	○目黒和幸 [†] 、黒須恵美 [†] 、石原綾子 [†] 、鈴木一孝 ^{††}	[†] 岩手県工業技術センター、 ^{††} 岩手大学
24A4-4	3月24日	15:05	(12) 配線板とその製造技術2	論文発表	レーザ誘起プレーティングによる金属パターニングへのパルスレーザ照射条件の影響	○上野翔太郎 [†] 、鈴木庸久 [†] 、藤井達也 [†] 、野村光由 [†] 、合谷賢治 [†] 、伊藤亮 ^{††}	[†] 秋田県立大学、 ^{††} 秋田県産業技術センター
24A5-1	3月24日	15:40	(12) 配線板とその製造技術2	依頼講演	溶融型導電ペーストによる高多層・高信頼Any Layer IVH基板技術	○飯田憲司	FICT(株)
24B1-1	3月24日	9:00	(01) カーエレクトロニクス実装	依頼講演	カーエレクトロニクスにおけるシミュレーションでのEMCおよび信頼性評価の最新情報	○三ノ上勝博	アンシス・ジャパン(株)
24B1-2	3月24日	9:30	(01) カーエレクトロニクス実装	論文発表	防湿コート剤の高速・高周波基板への影響調査	○酒井規光 [†] 、堀川敬 [†] 、稲川慎吾 [†] 、天野良治 ^{††} 、平林涼 ^{††} 、光山直之 ^{††} 、馬場清 ^{††††}	[†] 日産自動車(株)、 ^{††} AGCセイミケミカル(株)、 ^{†††} NECプラットフォームズ(株)、 ^{††††} メイコー
24B1-3	3月24日	9:45	(01) カーエレクトロニクス実装	論文発表	パワーモジュール設計で求められる協調設計と構想設計	○古賀一成、中道貴則、小林由一、岡和磨	(株)図研
24B2-1	3月24日	10:20	(14) 電子部品・実装技術	論文発表	格子ボルツマン法F0Dによる樹脂注入性解析	○宮田裕志 [†] 、斉藤寛之 ^{††} 、榎本利章 ^{††}	[†] ダッソー・システムズ㈱、 ^{††} ナミックス㈱
24B2-2	3月24日	10:35	(14) 電子部品・実装技術	論文発表	銀ペーストとセラミックス、半導体との低温無加圧直接焼結接合技術	○陳伝形、張政、菅沼克昭	大阪大阪
24B2-3	3月24日	10:50	(14) 電子部品・実装技術	論文発表	半導体センサチップ単体の温度特性評価手法	○王植 [†] 、芦田喜章 [†] 、青野宇紀 [†] 、宮崎健太郎 ^{††} 、有働電二郎 ^{††} 、久保田記章 ^{††}	[†] (株)日立製作所、 ^{††} (株)グローセル
24B2-4	3月24日	11:05	(14) 電子部品・実装技術	論文発表	高光取出し効率を実現したUV光源用シール材付きリッドの開発	○間高亮太	日本電気硝子(株)
24B2-5	3月24日	11:20	(14) 電子部品・実装技術	論文発表	ガラス基板と異方性導電フィルムの表面冷却式レーザ接合	○佐藤公俊 [†] 、李治蒙 ^{††}	[†] 国土領大学、 ^{††} 深圳漢和智造有限公司
24B3-1	3月24日	13:00	(09) 高速伝送/回路実装/高周波1	論文発表	ウェアラブルセンサの試作とエレメカ設計環境を使った構造検討	○長谷川清久 [†] 、山本愛優美 ^{††} 、谷口英俊 ^{†††}	[†] (株)図研、 ^{††} Nexstar、 ^{†††} 図研テック(株)
24B3-2	3月24日	13:15	(09) 高速伝送/回路実装/高周波1	論文発表	大容量3.5型HDDを実現するプリント基板の高密度実装技術	○岡野太一、徳田孝太、梶桂子、石崎聖和	[†] 東芝デバイス&ストレージ㈱
24B3-3	3月24日	13:30	(09) 高速伝送/回路実装/高周波1	論文発表	プリント配線板のグラウンドバウンス評価と定式化	○鳥崎隆	三菱電機(株)
24B3-4	3月24日	13:45	(09) 高速伝送/回路実装/高周波1	論文発表	無線エネルギーハーベスティング回路の開発及びBluetooth通信実験	○鳥越翔太 [†] 、山本修也 [†] 、保坂亮磨 [†] 、MOHAMED M. MANSOUR ^{††} 、滝口収 ^{†††} 、村上雅哉 ^{††††} 、金谷晴一 [†]	[†] 九州大学大学院、 ^{††} (株)キオクシア(株)、 ^{†††} アルセンス(株)、 ^{††††} (株)正興電機製作所
24B3-5	3月24日	14:00	(09) 高速伝送/回路実装/高周波1	論文発表	経皮エネルギー伝送用コイルの変形に対する伝送特性	○坂本世成、越地福朗	東京工芸大学
24B4-1	3月24日	14:35	(09) 高速伝送/回路実装/高周波2	論文発表	ミリ波帯における同軸ケーブルとコネクタの結合部における緩みによる計算値と実測値の比較に関する研究	○蓮沼栄太郎 [†] 、福嶋隆広 ^{††} 、前山利幸 [†]	[†] 拓殖大学大学院、 ^{††} (株)I-PEX
24B4-2	3月24日	14:50	(09) 高速伝送/回路実装/高周波2	論文発表	ワイヤレス電力伝送用コイルの交流抵抗を低減する研究	○菊地秀雄 [†] 、中島彩奈 ^{††} 、茂木和弘 [†] 、白石洋一 [†]	[†] 群馬大学大学院、 ^{††} 長野工業高等専門学校
24B4-3	3月24日	15:05	(09) 高速伝送/回路実装/高周波2	論文発表	方向性結合器基板を用いた電磁波吸収体のノイズ抑制性能評価	○野末修平、本木浩之、田中顕裕	RITAエレクトロニクス㈱
24B4-4	3月24日	15:20	(09) 高速伝送/回路実装/高周波2	論文発表	半導体EMCモデリング国際規格とその応用	○富島敦史、阿川謙一、今泉祐介、宮原秀敏、黒須篤	東芝デバイス&ストレージ(株)
24B4-5	3月24日	15:35	(09) 高速伝送/回路実装/高周波2	論文発表	ITO透明導電膜で形成するマイクロストリップ線路の伝送特性の検討	○鈴木美里、越地福朗、山田友里、安田洋司、山田勝美、内田孝幸	東京工芸大学
24B5-1	3月24日	16:10	(09) 高速伝送/回路実装/高周波3	論文発表	短波帯広帯域通信における無線通信範囲を制限するアンテナの設計方法	○仙波拓人、桑原堅誠、脇坂俊幸、松嶋徹、福本幸弘	九州工業大学
24B5-2	3月24日	16:25	(09) 高速伝送/回路実装/高周波3	論文発表	磁性体薄膜による28GHz帯単方向スロットアンテナの特性向上に関する研究	○宮原 鼓人 [†] 、石橋 毅之 ^{††} 、タム キム コング ^{†††} 、金谷 晴一 [†]	[†] 九州大学大学院、 ^{††} 竹田中貴金属工業(株)
24B5-3	3月24日	16:40	(09) 高速伝送/回路実装/高周波3	論文発表	ベイズ最適化による28GHz帯単方向スロットアンテナの設計および試作・評価	○竹上航平、山本駿佑、金谷晴一	九州大学大学院
24B5-4	3月24日	17:10	(09) 高速伝送/回路実装/高周波3	論文発表	メイン基板の形状を考慮した2.4GHz帯単方向指向性スロットアンテナの設計	○佐川哲哉 [†] 、小牧一郎 [†] 、大川由貴 ^{††} 、小橋泰成 ^{††} 、金谷晴一 [†]	[†] 九州大学、 ^{††} (株)Braveridge
24B5-5	3月24日	17:25	(09) 高速伝送/回路実装/高周波3	論文発表	4周波遮断帯域を有するUNB用半円台形不平衡ダイポールアンテナの検討	○古川宙磨、越地福朗	東京工芸大学
24C1-1	3月24日	9:30	(22) チュートリアル1	依頼講演	電子機器における電子回路実装の重要性及びパワーエレクトロニクス人材育成	○羽深等	横浜国立大学大学院
24C1-2	3月24日	10:00	(22) チュートリアル1	依頼講演	プリント配線板のいままでとこれから	○八甫谷明彦	よこはま高度実装技術コンソーシアム
24C2-1	3月24日	13:00	(22) チュートリアル2	依頼講演	電子機器の超高速化やウェアラブル化で半導体デバイス・配線板実装構造が変わる！	○本多進	よこはま高度実装技術コンソーシアム
24C2-2	3月24日	13:50	(22) チュートリアル2	依頼講演	たかがコンデンサ されどコンデンサ	○梶田栄	NPOサーキットネットワーク
24C3-1	3月24日	15:00	(22) チュートリアル3	依頼講演	日本の電子Jisso R&D技術が生き残るには何が必要か？	○高橋邦明	㈱産業分析センター
24C3-2	3月24日	15:50	(22) チュートリアル3	依頼講演	「ローカル5G」は地方を救う	○宮代文夫	よこはま高度実装技術コンソーシアム
24D1-1	3月24日	13:30	JSAP・JIEP協業シンポジウム	依頼講演	「量子コンピュータ：システム構築のための技術と期待されるアプリケーション(Ⅱ)」		